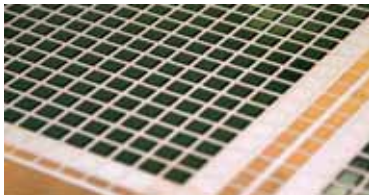


## 大大提升先进封装组装的生产力

### 先进功能应对先进应用



可应对完整系列的有源及无源器件  
尺寸：008004 – 100 x 100毫米  
厚度：50微米– 25毫米



可以在任何基板上贴装  
尺寸：20 x 20毫米– 813 x 610毫米  
厚度：50微米 – 12.7毫米



全面的工艺开发

www.uic.com | 电邮：universal@uic.com

MC-6687B CH

©2019 环球仪器

版权归环球仪器所有，文件所列技术参数可能变更。

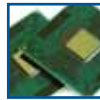
美洲  
电话：1-800-432-2607  
电话：+1-607-779-7522

中国深圳  
电话：+86-755-2685-9108

欧洲  
电话：+421-2-4930-96-60

中国上海  
电话：+86-21-6495-2100

马来西亚槟城  
电话：+60-4-644-7067



倒装芯片封装



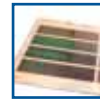
系统级封装



晶圆级封装



FUZION<sup>sc</sup>



嵌入式封装



高精度贴装



多芯片扇出型封装

### 以表面贴装速度实现半导体技术

一体式多功能平台能应对任何先进封装挑战

- 高精度：<10微米，速度：16K cph，面积：813 x 610毫米
- 可以使用任何送料器(晶圆级、盘式、卷带盘式、管式、散装式、直接晶圆式)
- 同一平台上高精度贴装有源及无源器件
- 可以在任何基板上贴装，包括薄/柔板
- 先进工艺实验室支持：先进的工艺及材料专家，优化工艺流程，失效分析

FUZIONSC 视频(点击这里观看)

